

第40回エレクトロニクス実装学会春季講演大会 暫定プログラム (法人名にて掲載)

※変更する場合もございます

3月10日(火)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術1 座長:大島 心平 (小山工業高等専門学校)	材料技術 座長:	3D・チップレット技術1 座長:福島 誠史 (東北大)	生成AI 実装技術1 座長:中上 京治 (ダイヤゼブ)
時間	10:00 10A1-1 (0020) ダイレクト接合技術によるガラス基板上の平面型25GHz帯アンプの実装 石田 遼馬 (九州大学)	10B1-1 (0026) 半導体パッケージ内に形成される異種結晶界面の安定化プロセス 河野 長村 (ニセコセミコンダクタリューション)	10C1-1 (0003) TSV形成プロセスにおけるSi Deep RIEのマイクローディング効果 吉田 龍人 (コネクテクジャパン)	10D1-1 (0067) シリコンアーチメント制作支援のための進化アルゴリズムに基づく背景生成手法 津浦 実 (群馬大学)
	10:15 10A1-2 (0105) キャビン式荷物輸送機器接合構造を用いた有極型市場分析からみる業界動向 青木 正光 (日本環境技術推進機構)	10B1-2 (0041) 市場分析からみる業界動向 園田 康太郎 (熊本大学)	10C1-2 (0110) 三次元構造実装に向けた高アベラクツ比5um TSV形成プロセス開発・電気特性評価 王 鈞 (群馬大学)	10D1-2 (0081) シリコンアーチメント制作支援のための背景情報を利用したStable Video Diffusionの実装化手法 鈴木 勝実 (群馬大学)
	10:30 10A1-3 (0106) 横層構造によるストリップ線路を用いたカルデサウル型フレーム設計に関する検討 渡辺 誠午 (電気通信大学)	10B1-3 (0042) 銅錫を用いた鋼ナノ粒子ベーストの低温接合 今東 孝之 (ニセコセミコンダクタリューション)	10C1-3 (0070) Chip on Wafer上にシリコンアーチメントの形成による画像補間のための画像動画の実験 山崎 達也 (大陽工房)	10D1-3 (0037) シリコンアーチメント制作支援における画像補間のための画像動画の実験 劉 豊垣 (群馬大学)
	10:45 10A1-4 (0075) 多周波無線システムにおけるマイクロストリップブリッジの設計 徐 瑞豪 (電気通信大学)	10B1-4 (0052) 温度サイクルによるダイオードはんだ接合部の結晶方位変化 木村 昿翔 (大阪大学)	10C1-4 (0047) 歩行リバーラーにおける計測の自動化と予測モデル構築に関する研究 石井 大地 (長野工業高等専門学校)	10D1-4 (0001) 不織布を基材とした表面增强ランダム基板を用いたアルドトレス検出システムの開発 川口 勝也 (信州大学)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術2 座長:五百旗頭 健吾 (岡山大学)	材料技術 座長:	3D・チップレット技術2 座長:安田 清和 (大阪大学)	生成AI 実装技術2 座長:中上 京治 (ダイヤゼブ)
	11:15 10A2-1 (0121) 集中定数素子を用いたBPFと整合回路の統合設計法 大島 心平 (小山工業高等専門学校)	10B2-1 (0064) YOLOによる顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 藤井 俊輔 (九州大学)	10C2-1 (0055) SICN膜の膜質がハイブリッドボーリングに及ぼす影響 松木 淳一郎 (電気通信大学)	10D2-1 (0055) YOLOを用いた顔画像によるリアルタイム個人認証の実験評価 木上 雅博 (群馬大学)
	11:30 10A2-2 (0027) 多層基板上に構築したストリップ回路共振器によるパルス回路設計 藤井 俊輔 (九州大学)	10B2-2 (0113) YOLOによる顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 秋林 和洋 (群馬大学)	10C2-2 (0115) ハイブリッド接合ためのワイヤー干渉計を用いたトポグラフィ解析と接合性評価 佐藤 遼一 (東北大)	10D2-2 (0056) YOLOによる顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 白石 洋一 (群馬大学)
	11:45 10A2-3 (0127) チップ素子、MSL、SIW構造を用いたトリップゲート設計に関する検討 吉田 健人 (電気通信大学)	10B2-3 (0096) 半導体パッケージ回路検査用微細プローブ組立への銀微粒子焼結接合の適用 福島 孝典 (群馬大学)	10C2-3 (0053) SICN膜の膜質がハイブリッドボーリングに及ぼす影響 中山 凉平 (パナソニックホールディングス)	10D2-3 (0040) YOLOを用いた顔画像によるリアルタイム個人認証の実験評価 白石 洋一 (群馬大学)
	12:00 10A2-4 (0076) 可変ピーダース移相器における位相制御部圧のシミュレーション実験の整合性に関する検討 吉田 健人 (電気通信大学)	10C2-4 (0031) マテリアル・インターフェイスと分子シミュレーションによる界面強度向上設計 岩崎 富生 (立製作所)	10D2-4 (0046) 機械学習を利用した写真寫真から的人物検出手法の検討 柳澤 陽成 (長野工業高等専門学校)	
12:15	昼食 12:15~13:15 (60分)			
	B会場使用不可 12:00~13:35			
	セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術3 座長:川上 雄士 (大阪工業大学)	サーマルマニーマント&パワーエレクトロニクス実装1 座長:山岸 友行 (富山県立大学)	生成AI 実装技術3 座長:高橋 修司 (図研)
	13:15 10A3-1 (0025) 8GHz帯 円偏波UWBストアントナの開発 本田 敬士 (九州大学)	10C3-1 (0051) コントラスト材の熱伝導に寄与するh-BNによる界面強度向上設計 松川 和幸 (三菱電機)	10D3-1 (0086) Raspberry Pi用に、フルスケール表示可能な装着の実装 速 浩 (群馬大学)	
	13:30 10A3-2 (0107) スクロール線路コマーラ線路を用いたフィルタングアーティファクトの設計に関する検討 河野 通樹 (電気通信大学)	10C3-2 (0008) 3次元熱抵抗を考慮したTDI法によるSIC/パワモジールのシミュレーションによる抵抗評価 吉田 努 (パナソニックインダストリー)	10D3-2 (0086) Raspberry Pi用に、フルスケール表示可能な装着の実装 速 浩 (群馬大学)	
	13:45 10A3-3 (0022) 反射角制御型ターゲットの構造設計と電波放射抑制への応用 LI HAITAO (九州大学)	10C3-3 (0068) 3Dプリンターを利用した鉄鋼と樹脂の真材接合 田中 努 (大阪産業技術研究所)	10D3-3 (0019) 10D3-3 (0068) 10D3-4 (0128) 10D3-5 (0136)	10D3-3 (0019) 10D3-4 (0128) 10D3-5 (0083) 10D4-2 (0134)
	14:00 10A3-4 (0061) 第2世代移動通信システム用7GHz帯透明電磁シールドの検討 佐藤 潤弥 (東京工芸大学)	10C3-4 (0135) 光チャップレット内に蔵されたチップの放熱経路に関する考察 星野 雄基 (NTTデバイスクリエイション)	10D3-4 (0128) 自己組織化アップを用いた人の行動分類手法の検討 原田 創意 (長野工業高等専門学校)	10D3-5 (0083) 10D4-2 (0134)
	14:15 14:15~14:30 (15分) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術4 座長:松崎 徹 (九州工業大学)	10C3-5 (0136) 光チャップレットの冷却方法の検討 永木 郁朗 (NTTデバイスクリエイション)	10D3-5 (0083) 10D4-2 (0134)	
	14:30 10A4-1 (0023) UHF帯CMOSエネルギー・ハーベステイング回路の設計 SUN YUCHEN (九州大学)	10D4-1 (0023) 固体イオン交換法を援用したガラス内銀析出現象の動的観察および評価 河野 美優香 (千葉大学)	10D4-1 (0066) 10D4-1 (0066) 10D4-1 (0126)	10D4-2 (0058) 10D4-2 (0134)
	14:45 10A4-2 (0021) 地上波放送、LTE、Wi-Fi対応3/CDM用差動型RFアンプの設計と実装 中澤 海斗 (九州大学)	10D4-2 (0113) エポキシ樹脂の硬化反応へのシリカフラーの影響に関する解析 仲 啓志 (東リサーチセンター)	10D4-3 (0116) 10D4-3 (0018)	10D4-2 (0058) 10D4-2 (0134)
	15:00 10A4-3 (0073) 整流器のACモードを使用した2MHz磁気結合共振 WPTシステムのミリ波通信 菊地 秀雄 (群馬大学)	10D4-3 (0144) 10D4-3 (0145) 10D4-4 (0090)	10D4-4 (0131)	10D4-2 (0134)
	15:15 10A4-4 (0077) 複数のSDRの同期処理に関する検討 川上 雄士 (大阪工業大学)	10D4-4 (0116) ICチップのセキリティに対するパッケージと回路技術の進化 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授 福田 盛介 氏	10D4-4 (0116) Ultra-Wide Band周波数帯における受信機構成最適化 Kaiman2ルームにおける業者の位置推定 井上 采都 (群馬大学)	10D4-2 (0134)
	15:30 10A4-5 (0075) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術5 座長:室賀 翔 (東北大)	10D4-4 (0098)	10D4-4 (0131)	10D4-2 (0134)
	15:45 10A5-1 (0093) 電磁界シミュレーションを用いて基板の複素誘電率を推定する近似手法に関する検討 松浦 弘樹 (電気通信大学)	10D4-4 (0098) 金薄層転写により平滑化したダイヤモンド基板と室化ガラスチップの大気中常温接合 後藤 健太郎 (東北大)	10D4-5 (0131)	10D4-2 (0134)
	16:00 10A5-2 (0033) ハイブリッド回路におけるWPT接続板における高周波伝送性能の評価と信号伝送品質の検証 宮川 幸三 (菱電電子)	10D4-5 (0095)	10D4-5 (0131)	10D4-2 (0134)
	16:15 10A5-3 (0050) DDR4 Fly-by-wireにおけるリード型スリップ短絡配線の波形品質と見える影響 澤木 信悟 (立製作所)	10D4-5 (0131)	10D4-5 (0131)	10D4-2 (0134)
	16:30 10A5-4 (0093) 超広域双方向吸収コモンモードフィルタの設計と波形の測定 成島 章太 (電気通信大学)	10D4-5 (15:30~16:30)		

3月11日(水)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション	マイクロメカトロニクス実装技術1 座長:森田 伸友 (産業技術総合研究所)	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術6 座長:松嶋 徹 (九州工業大学)	光回路実装技術1 座長:竹崎 元人 (白山)	MES2025受賞講演 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所) MES2025論文委員長
時間	10:00 11A1-1 (0016) 半導体パッケージ内に形成される異種結晶界面の安定化プロセス 河野 長村 (ニセコセミコンダクタリューション)	11B1-1 (0049) シリコンアーチメント制作支援のためのノード炉による熱抵抗の改善 Gallegos Alessandra (京都先端科学大学)	11C1-1 (0099) Co-packaged optoelectronicsにおけるモードノイズを重視したシリコンアーチメントとガラス基板の接合 島嶋 陽貴 (鹿児島県立大学)	11D1-1 (0142) 高周波数信号モデルを用いた超音波電波吸収体における電波吸収特性の推定 鈴木 勝 (東北大)
	10:15 11A1-2 (0035) 市場分析からみる業界動向 園田 康太郎 (熊本大学)	11B1-2 (0071) シリコンアーチメント制作支援における画像補間のための画像動画 高木 球玲 (東芝)	11C1-2 (0043) 高環境耐性を有するシリコンモードドリーバーによる高周波電波吸収 谷内 冬馬 (住友ベークライト)	11D1-2 (0143) 波路の開発 佐々木 こ (京セラ)
	10:30 11A1-3 (0124) 鋼錫を用いた鋼ナノ粒子ベーストの低温接合 今東 孝之 (ニセコセミコンダクタリューション)	11B1-3 (0088) QCMによる水中揮発性脂防酸素計測 下田 順 (東大)	11C1-3 (0093) シリコンアーチメント埋め込み技術を用いた光電 集積回路の開発 上村 茂樹 (京セラ)	11D1-3 (0145) 半導体ICのEMI吸収技術 羽谷 成正 (ソシオネットストラット)
	10:45 11A1-4 (0075) 多周波無線システムにおけるマイクロストリップ ブリッジの設計 徐 瑞豪 (電気通信大学)	11B1-4 (0078) 歩行リバーラーにおける計測の自動化と予測モデル構築に関する研究 石井 大地 (長野工業高等専門学校)	11C1-4 (0111) CWDW ELSFBモジュールの光出力特性 白石 勇希 (古河電気工業)	11D1-4 (0145) 接着剤による接着強度評価 横谷 光 (群馬大学)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術2 座長:五百旗頭 健吾 (岡山大学)	材料技術 座長:	3D・チップレット技術2 座長:安田 清和 (大阪大学)	生成AI 実装技術2 座長:中上 京治 (ダイヤゼブ)
	11:15 10A2-1 (0121) 集中定数素子を用いたBPFと整合回路の統合 設計法 大島 心平 (小山工業高等専門学校)	10B2-1 (0064) YOLOによる顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 高野 駿 (鹿児島大学)	10C2-1 (0055) YOLOを用いた顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 佐藤 遼一 (東北大)	10D2-1 (0046) YOLOを用いた顔認識技術を用いた自動車ナンバープレート同一性の検証 白石 洋一 (群馬大学)
	11:30 10A2-2 (0027) 多層基板上に構築したストリップ回路共振器によるパルス回路設計 藤井 俊輔 (九州大学)	10B2-2 (0113) ハイブリッド接合ためのワイヤー干渉計を用いたトポグラフィ解析と接合性評価 秋林 和洋 (群馬大学)	10C2-2 (0115) ハイブリッド接合ためのワイヤー干渉計を用いたトポグラフィ解析と接合性評価 松浦 駿 (東大)	10D2-2 (0056) ハイブリッド接合ためのワイヤー干渉計を用いたトポグラフィ解析と接合性評価 秋林 和洋 (群馬大学)
	11:45 10A2-3 (0127) チップ素子、MSL、SIW構造を用いたトリップゲート設計 吉田 健人 (電気通信大学)	10B2-3 (0042) 半導体パッケージの熱伝導に寄与するh-BNによる界面強度向上設計 福島 孝典 (群馬大学)	10C2-3 (0053) SICN膜の膜質がハイブリッドボーリングに及ぼす影響 中山 凉平 (パナソニックホールディングス)	10D2-3 (0040) YOLOを用いた顔認識技術によるリアルタイム個人認証の実験評価 白石 洋一 (群馬大学)
12:00	休憩 12:00~13:35 (60分)			
	セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術3 座長:川上 雄士 (大阪工業大学)	サーマルマニーマント&パワーエレクトロニクス実装1 座長:山岸 友行 (富山県立大学)	生成AI 実装技術3 座長:高橋 修司 (